

Série GLANZOX E

Polimento de arestas de silício



This photograph is an image. Esta fotografia é uma imagem.

GLANZOX

With the increasing integration of semiconductor devices and the larger size of wafers, a damage-, haze- and heavy metal contamination free, flat, as well as nanotopography mirror-like silicon surface is essential. Fujimi's GLANZOX series was developed to meet such requirement. GLANZOX polish consists of colloidal silica dispersed in a liquid composed of special ingredients. This product results in an almost perfectly polished surface. In response to the recent demand for considerable reductions in the metal impurities that affect device characteristics, higher-grades of polish containing ultra-pure colloidal silica have been developed.

GLANZOX

Com a crescente integração de dispositivos semicondutores e tamanhos maiores das pastilhas de silício, torna-se essencial uma superfície de silício sem danos, embaciamento e contaminação por metais pesados, plana, tal como se se tratasse de um espelho de nanotopografia. A série GLANZOX da Fujimi foi desenvolvida para responder a tais exigências. O polimento GLANZOX consiste de sílica coloidal dispersa num líquido composto de ingredientes especiais. Este produto resulta numa superfície quase perfeitamente polida. Em resposta à recente procura de reduções consideráveis nas impurezas dos metais que afetam as características do dispositivo, foram desenvolvidos elevados graus de polimento que contêm sílica coloidal ultra-pura.

Typical Physical Properties of GLANZOX

Propriedades físicas típicas do GLANZOX

Item / Item	Type / Tipo	1103	1302	1304	3500
Main component / Componente principal		Ultra-pure SiO ₂ (colloidal) / SiO ₂ ultra-puro (coloidal)	pure SiO ₂ (colloidal) / SiO ₂ puro (coloidal)	pure SiO ₂ (colloidal) / SiO ₂ puro (coloidal)	
Content of SiO ₂ (%) / Conteúdo de SiO ₂ (%)		17,5	18,5	18,5	—
PH		11,4	11,4	11,4	10,1
Specific gravity / Peso específico		1,1	1,1	1,1	1,0
Average particle size (nm) / Tamanho médio de partícula (nm)		35	35	9	—
Application / Aplicação		For First polishing / Para o primeiro polimento	For First polishing / Para o primeiro polimento	For First polishing / Para o primeiro polimento	—
Standard Net weight / Peso líquido Padrão		17 kg	10 kg	10 kg	10 kg
Drum / Tambor		220 kg	220 kg	220 kg	200 kg

Item / Item	Type / Tipo	3900	3900RS	3101	3100M
Main component / Componente principal		Ultra-pure SiO ₂ (colloidal) / SiO ₂ ultra-puro (coloidal)	pure SiO ₂ (colloidal) / SiO ₂ puro (coloidal)	pure SiO ₂ (colloidal) / SiO ₂ puro (coloidal)	pure SiO ₂ (colloidal) / SiO ₂ puro (coloidal)
Type of product / Tipo de produto		9,1	9,1	4,5	9,1
PH		10,5	10,5	10,6	10,3
Specific gravity / Peso específico		1,05	1,05	1,03	1,05
Average particle size (nm) / Tamanho médio de partícula (nm)		35	35	35	35
Application / Aplicação		Final For Final polishing / Final Para o polimento final	Final For Final polishing / Final Para o polimento final	Final For Final polishing / Final Para o polimento final	Final For Final polishing / Final Para o polimento final
Standard Net weight / Peso líquido Padrão		10 kg, 20 kg	10 kg	10 kg	10 kg
Drum / Tambor		200 kg	200 kg	200 kg	200 kg



FUJIMI INCORPORATED

1-1, Chiryō-2, Nishibiwajima-cho, Kiyosu, Aichi, 452-8502 Japan
 TEL(052)503-8112 FAX(052)503-7734
 TEL (052) 503-8112 FAX (052)503-7734
 1-1, Chiryō-2, Nishibiwajima-cho, Kiyosu, Aichi, 452-8502 Japão

Serie GLANZOX E

Polimento de arestas de silício

■ GLANZOX E-Series

With the increasing integration of semiconductor devices, wafer surfaces must be cleaned more efficiently than ever. To prevent dusting due to transportation and handling, and reinforcement of the edge surface, mirror-finishing of the edge surface must be performed during the wafer manufacturing process. GLANZOX E-Series high-efficiency polish was developed exclusively for mirror finishing of wafer edge surfaces. It is comprised of colloidal silica dispersed in a liquid composed of special ingredients, and is superior in terms of cleanability after polishing.

■ Série GLANZOX E

Com a crescente integração de dispositivos semicondutores, as superfícies das pastilhas de silício devem ser limpas de uma forma mais eficiente do que nunca. Para evitar o empoeiramento devido ao transporte e manuseamento e reforço da superfície da aresta, deve ser realizado o acabamento em espelho da superfície da aresta durante o processo de fabricação das pastilhas de silício. O polimento de alta eficiência da série GLANZOX E foi desenvolvido exclusivamente para acabamento de espelho das superfícies de aresta das pastilhas de silício. É constituído por sílica coloidal dispersa num líquido composto de ingredientes especiais e é superior em termos de capacidade de limpeza após o polimento.

Typical Physical Properties of GLANZOX E-Series

Propriedades físicas típicas da série GLANZOX E

Item / Item	Type / Tipo	E301	E303	E304
Main component / Componente principal		SiO ₂ (colloidal) / SiO ₂ (coloidal)	pure SiO ₂ (colloidal) / SiO ₂ puro (coloidal)	pure SiO ₂ (colloidal) / SiO ₂ puro (coloidal)
Content of SiO ₂ (%) / Conteúdo de SiO ₂ (%)		35	35	40
PH		11,5	10,6	11,6
Specific gravity / Peso específico		1,24	1,24	1,28
Average particle size (nm) / Tamanho médio de partícula (nm)		55	55	35
Kind of water / Tipo de água		bare silicon & oxide / silício bruto e óxido	bare silicon & oxide / silício bruto e óxido	bare silicon / silício bruto
Standard Net weight / Peso líquido Padrão		18 kg / 18 kg	20 kg / 20 kg	18 kg, 20 kg / 18 kg, 20 kg
Drum / Tambor		240 kg / 240 kg	240 kg / 240 kg	240 kg / 240 kg